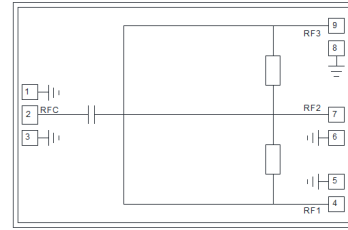


性能特点

- 频率范围：6–18GHz
- 插入损耗：0.5 dB
- 隔离度：20 dB
- 芯片尺寸：2.16X1.49X0.1 mm
- 100%在片测试

功能原理图



产品介绍

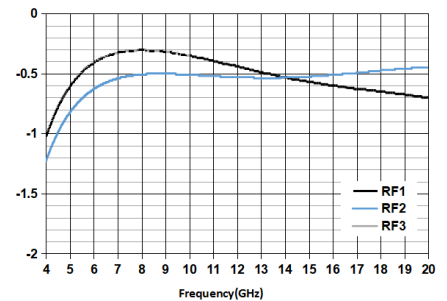
ZXA6511是一款单片集成3路功分器芯片 (Die),频率范围覆盖6–18GHz, 插入损耗 0.5dB, 回波损耗–18dB, 隔离度典型值20dB。芯片采用了片上通孔金属化工艺, 保证了良好的接地; 芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

电气性能参数 (TA = +25℃)

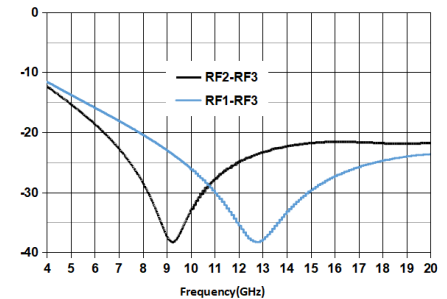
参数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	6		18	GHz
插入损耗		0.5		dB
隔离度		20		dB
回波损耗		–18		dB

典型测试曲线

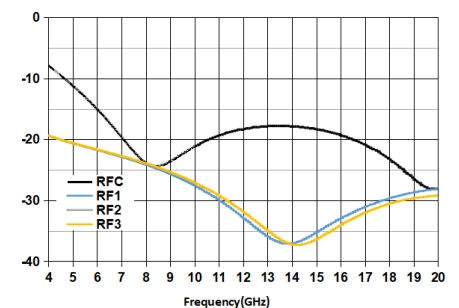
插入损耗 VS 频率



隔离度 VS 频率



回波损耗 VS 频率



使用限制参数

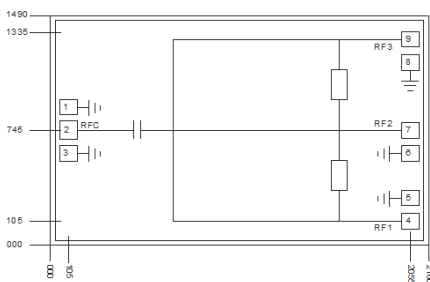
项目	数值
RFC	30 dBm
RF1,RF2	25 dBm
工作温度	–55 ~ +85 ℃
储存温度	–65 ~ +150 ℃

*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏



该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电

键合点定义



管脚	名称
2	RF C
4	RF 1
7	RF 2
9	RF 3
其他	GND

说明
1. RFC PAD:100um*120um
2. RF1,RF2 PAD:100um*100um

装配说明:

1. 芯片厚度100um。
2. 在净化环境装配使用, 不要碰触表面, 以免损伤芯片。
3. 输入输出使用2根金丝键合 (直径25um), 键合线尽量短, 不要长于400um。
4. 用Au80Sn20 金锡烧结, 温度不要超过300℃, 烧结时间不要超过 30 秒。
5. 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电。
6. 干燥、氮气环境下保存。